PAMBE 法による AIN/GaN 多層構造作製における 極薄 GaN 層の成長制御性に関する検討 Controllability of ultra-thin GaN layer growth in AIN/GaN multi-layered structure grown by PAMBE 京大院工¹⁰金子 光顕¹, 木本 恒暢¹, 須田 淳¹ Kyoto Univ.¹, [°]Mitsuaki Kaneko¹, Tsunenobu Kimoto¹, and Jun Suda¹ E-mail: kaneko@semicon.kuee.kyoto-u.ac.jp

我々はこれまで、PAMBE 法による SiC 基板上の AIN/GaN 短周期超格子の成長に関する研究を 進めてきた。XRD 2θ-ω スキャンにおいて明瞭なサテライトピークが確認できる超格子の作製に 成功したが、断面 TEM で詳細に評価すると、超格子の1層目の GaN 層の膜厚が不均一であるこ とがわかった[1]。超格子成長の下地となる AIN テンプレート層は、PAMBE による高品質成長条 件である Al-rich 条件で成長している。このとき、過剰な Al は表面に残留する。Al-N の結合エネ ルギーが Ga-N の結合エネルギーに比べて大きく[2]、供給された窒素を残留 Al が消費することで AIN が成長し、GaN 層の形成を阻害していたと考えられる。将来、デバイス構造を作製するため には、AIN/GaN 多層構造を制御性よく得ることが不可欠である。今回、AIN 層成長時の AI/N 比の 違い(Al-rich 度の違い)に着目し、AIN 層上の極薄 GaN 層の成長制御性を検討したので報告する。

7×8 mm の 6H-SiC (0001) 基板を使用し、Al、Ga、および ff プラズマ励 起活性化窒素(N*)を用いた MBE 法により成長を行った。成長した構造の 模式図を図 1 に示す。高品質 AlN テンプレート層を 19 nm 成長後、障壁 層である AlN 層厚を 10 nm と一定にし、井戸層である GaN 層を下から順 に 1, 2, 3, 4, 5 BL (1 BL~0.25 nm) と成長した。一般に、MBE 装置で は均一性向上のために基板回転を行うが、今回は AlN 層成長時の Al/N 比の影響を調べるため、基板を回転させずに成長し、意図的に Al/N 比の面内分布を生じさせた。その結果、サンプル表面でドロップレ ット密度が高い領域 (Al-rich) から低い領域 (slightly-Al-rich) へと 連続的に変化しているサンプルを得た。

GaN 層成長確認のためカソードルミネセンス(CL)測定および XRD 20-ω スキャンを行った。低温 CL 測定結果を図 2 に示す。Al-rich 領域では、AIN の欠陥起因のピーク(バイオレットルミネセンス、 VL)と SiC 基板のピークのみが観察された。XRD 20-ω スキャン結 果は膜厚 70 nmの AIN 単層に対応するプロファイルとなった。一方、 slightly-Al-rich 領域の CL スペクトルからは、極薄 GaN 層によ る量子井戸に対応すると考えられる 2 つのピークが確認され た。また、XRD 20-ω スキャン結果は AIN 単層のものと明らか に異なっており、GaN 層が成長できていると考えられる。そ れぞれの領域の AFM 像を図 3 に示す。Al-rich 領域では AIN

なっている。一方、slightly-Al-rich 領域では多数のピットが観 slightly-Al-rich and Al-rich region. 察された。過去の研究では、AlN/GaN 超格子を成長した際、3 BL の GaN 層を成長すると格子緩 和が生じた[3]。今回作製した構造では 3 BL 以上の GaN 層を含んでいたため、3 BL、あるいはそ れ以降の GaN 層で格子緩和が生じ、表面荒れが生じた可能性が考えられる。

[1] M. Kaneko, et. al., JJAP **52** (2013) 08JE21.

[2] E. Iliopoulos, et al., APL. 81 (2002) 295.

[3] R. Kikuchi, et. al., APEX 5 (2012) 051002.







Fig. 2: CL spectra of slightly-Al-rich and Al-rich region.



Fig. 3: Surface morphologies of slightly-Al-rich and Al-rich region.